

2021年中国半导体行业分析报告- 市场发展监测与投资规划分析

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国半导体行业分析报告-市场发展监测与投资规划分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/552273552273.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

观研报告网发布的《2021年中国半导体行业分析报告-市场发展监测与投资规划分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】第一章 半导体行业概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体产业链分析

1.2.1 半导体产业链结构

1.2.2 半导体产业链流程

1.2.3 半导体产业链转移

第二章 2017-2021年全球半导体产业发展分析

2.1 2017-2021年全球半导体市场总体分析

2.1.1 市场销售规模

2.1.2 产业研发投入

2.1.3 行业产品结构

2.1.4 区域市场格局

2.1.5 企业营收排名

2.1.6 市场规模预测

2.2 美国半导体市场发展分析

2.2.1 产业发展综述

2.2.2 市场发展规模

2.2.3 市场贸易规模

2.2.4 研发投入情况

2.2.5 产业发展战略

2.2.6 未来发展前景

2.3 韩国半导体市场发展分析

2.3.1 产业发展阶段

2.3.2 产业发展现状

2.3.3 市场发展规模

2.3.4 企业规模状况

2.3.5 市场贸易规模

2.3.6 产业发展规划

2.4 日本半导体市场发展分析

2.4.1 行业发展历史

2.4.2 市场发展规模

2.4.3 企业运营情况

2.4.4 市场贸易状况

2.4.5 细分产业状况

2.4.6 行业发展经验

2.5 其他国家

2.5.1 荷兰

2.5.2 英国

2.5.3 法国

2.5.4 德国

第三章 中国半导体产业发展环境分析

3.1 宏观经济环境

- 3.1.1 宏观经济概况
- 3.1.2 对外经济分析
- 3.1.3 工业运行情况
- 3.1.4 固定资产投资
- 3.1.5 宏观经济展望
- 3.2 社会环境
 - 3.2.1 移动网络运行状况
 - 3.2.2 电子信息产业增速
 - 3.2.3 电子信息设备规模
- 3.3 技术环境
 - 3.3.1 研发经费投入增长
 - 3.3.2 摩尔定律发展放缓
 - 3.3.3 产业专利申请状况

第四章 中国半导体产业政策环境分析

- 4.1 政策体系分析
 - 4.1.1 管理体制
 - 4.1.2 政策汇总
 - 4.1.3 行业标准
 - 4.1.4 政策规划
- 4.2 重要政策解读
 - 4.2.1 集成电路高质量发展政策原文
 - 4.2.2 集成电路高质量发展政策解读
 - 4.2.3 集成电路产业发展推进纲要解读
 - 4.2.4 集成电路产业发展进口税收政策
- 4.3 相关政策分析
 - 4.3.1 中国制造支持政策
 - 4.3.2 智能制造发展战略
 - 4.3.3 产业投资基金支持
- 4.4 政策发展建议
 - 4.4.1 提高政府专业度
 - 4.4.2 提高企业支持力度
 - 4.4.3 实现集中发展规划
 - 4.4.4 成立专业顾问团队
 - 4.4.5 建立精准补贴政策

第五章 2017-2021年中国半导体产业发展分析

5.1 中国半导体产业发展背景

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 产业重要事件

5.1.3 科创板企业业绩

5.1.4 大基金投资规模

5.2 2017-2021年中国半导体市场运行状况

5.2.1 产业销售规模

5.2.2 产业区域分布

5.2.3 国产替代加快

5.2.4 市场需求分析

5.3 半导体行业财务状况分析

5.3.1 经营状况分析

5.3.2 盈利能力分析

5.3.3 营运能力分析

5.3.4 成长能力分析

5.3.5 现金流量分析

5.4 半导体行业工艺流程用膜分析

5.4.1 蓝膜晶圆的介绍及用途

5.4.2 晶圆制程保护膜的应用

5.4.3 半导体封装DAF膜介绍

5.4.4 晶圆芯片保护膜的封装需求

5.4.5 氧化物半导体薄膜制备技术

5.5 中国半导体产业发展问题分析

5.5.1 产业发展短板

5.5.2 技术发展壁垒

5.5.3 贸易摩擦影响

5.5.4 市场垄断困境

5.6 中国半导体产业发展措施建议

5.6.1 产业发展战略

5.6.2 产业发展路径

5.6.3 研发核心技术

5.6.4 人才发展策略

5.6.5 突破垄断策略

第六章 2017-2021年中国半导体行业上游半导体材料发展综述

6.1 半导体材料相关概述

6.1.1 半导体材料基本介绍

6.1.2 半导体材料主要类别

6.1.3 半导体材料产业地位

6.2 2017-2021年全球半导体材料发展状况

6.2.1 市场规模分析

6.2.2 细分市场结构

6.2.3 区域分布状况

6.2.4 市场发展预测

6.3 2017-2021年中国半导体材料行业运行状况

6.3.1 应用环节分析

6.3.2 产业支持政策

6.3.3 市场规模分析

6.3.4 市场份额分析

6.3.5 十强企业排名

6.3.6 企业相关规划

6.3.7 细分市场结构

6.3.8 项目建设动态

6.3.9 国产替代进程

6.4 半导体制造主要材料：硅片

6.4.1 硅片基本简介

6.4.2 硅片生产工艺

6.4.3 市场发展规模

6.4.4 市场份额分析

6.4.5 市场竞争状况

6.4.6 市场产能分析

6.4.7 市场发展前景

6.5 半导体制造主要材料：靶材

6.5.1 靶材基本简介

6.5.2 靶材生产工艺

6.5.3 市场发展规模

6.5.4 全球市场格局

6.5.5 国内市场格局

6.5.6 技术发展趋势

6.6 半导体制造主要材料：光刻胶

6.6.1 光刻胶基本简介

6.6.2 光刻胶工艺流程

6.6.3 市场规模分析

6.6.4 各厂商市占率

6.6.5 企业运营情况

6.6.6 市场竞争状况

6.6.7 市场需求分析

6.6.8 行业发展瓶颈

6.7 其他主要半导体材料市场发展分析

6.7.1 掩膜版

6.7.2 CMP材料

6.7.3 湿电子化学品

6.7.4 电子气体

6.7.5 封装材料

6.8 中国半导体材料行业存在的问题及发展对策

6.8.1 行业发展滞后

6.8.2 产品同质化问题

6.8.3 核心技术缺乏

6.8.4 行业发展建议

6.8.5 行业发展思路

6.9 半导体材料产业未来发展前景展望

6.9.1 行业发展趋势

6.9.2 行业需求分析

6.9.3 行业前景分析

第七章 2017-2021年中国半导体行业上游半导体设备发展分析

7.1 半导体设备相关概述

7.1.1 半导体设备重要作用

7.1.2 半导体设备主要种类

7.2 全球半导体设备市场发展形势

7.2.1 市场销售规模

7.2.2 市场区域格局

7.2.3 市场份额分析

7.2.4 市场竞争格局

7.2.5 重点厂商介绍

7.2.6 厂商竞争优势

7.3 2017-2021年中国半导体设备市场发展现状

7.3.1 市场销售规模

7.3.2 市场需求分析

7.3.3 市场国产化率

7.3.4 行业进口情况

7.3.5 企业运营情况

7.4 半导体产业链主要环节核心设备分析

7.4.1 硅片制造设备

7.4.2 晶圆制造设备

7.4.3 封装测试设备

7.5 中国半导体设备市场投资机遇分析

7.5.1 行业投资机会分析

7.5.2 细分市场发展趋势

7.5.3 产业政策扶持发展

第八章 2017-2021年中国半导体行业中游集成电路产业分析

8.1 2017-2021年中国集成电路产业发展综况

8.1.1 集成电路产业链

8.1.2 产业发展特征

8.1.3 产业销售规模

8.1.4 产品产量规模

8.1.5 市场贸易状况

8.1.6 人才需求规模

8.2 2017-2021年中国IC设计行业发展分析

8.2.1 行业发展历程

8.2.2 行业发展态势

8.2.3 市场发展规模

8.2.4 企业发展状况

8.2.5 企业营收排名

8.2.6 产业地域分布

8.2.7 产品领域分布

8.2.8 行业面临挑战

8.3 2017-2021年中国IC制造行业发展分析

8.3.1 晶圆生产工艺

8.3.2 晶圆加工技术

8.3.3 市场发展规模

8.3.4 产能分布状况

8.3.5 企业排名状况

8.3.6 代工企业营收

8.3.7 行业发展措施

8.4 2017-2021年中国IC封装测试行业发展分析

8.4.1 封装基本介绍

8.4.2 主要技术分析

8.4.3 芯片测试原理

8.4.4 芯片测试分类

8.4.5 市场发展规模

8.4.6 企业规模分析

8.4.7 企业营收排名

8.4.8 技术发展趋势

8.5 中国集成电路产业发展思路解析

8.5.1 产业发展建议

8.5.2 产业突破方向

8.5.3 产业创新发展

8.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

8.6.1 全球市场趋势

8.6.2 行业发展机遇

8.6.3 市场发展前景

第九章 2017-2021年其他半导体细分行业发展分析

9.1 传感器行业分析

9.1.1 产业链结构分析

9.1.2 市场发展规模

9.1.3 市场结构分析

9.1.4 区域分布格局

9.1.5 市场竞争格局

9.1.6 主要竞争企业

9.1.7 行业发展问题

9.1.8 行业发展对策

9.1.9 市场发展态势

9.2 分立器件行业分析

9.2.1 整体发展态势

9.2.2 市场供给状况

9.2.3 市场销售规模

9.2.4 贸易进口规模

9.2.5 竞争主体分析

9.2.6 行业进入壁垒

9.2.7 行业技术水平

9.2.8 行业发展前景

9.3 光电器件行业分析

9.3.1 行业政策环境

9.3.2 行业产量规模

9.3.3 项目投资动态

9.3.4 行业面临挑战

9.3.5 行业发展策略

第十章 2017-2021年中国半导体行业下游应用领域发展分析

10.1 半导体下游终端需求结构

10.2 消费电子

10.2.1 产业发展规模

10.2.2 产业创新成效

10.2.3 投资热点分析

10.2.4 产业发展趋势

10.3 汽车电子

10.3.1 产业相关概述

10.3.2 产业链条结构

10.3.3 市场规模分析

10.3.4 企业空间布局

10.3.5 技术发展方向

10.3.6 市场前景预测

10.4 物联网

10.4.1 产业核心地位

10.4.2 产业模式创新

10.4.3 市场规模分析

10.4.4 产业存在问题

10.4.5 产业发展展望

10.5 创新应用领域

10.5.1 5G芯片应用

10.5.2 人工智能芯片

10.5.3 区块链芯片

第十一章 2017-2021年中国半导体产业区域发展分析

11.1 中国半导体产业区域布局分析

11.2 长三角地区半导体产业发展分析

11.2.1 区域市场发展形势

11.2.2 协同创新发展路径

11.2.3 上海产业发展状况

11.2.4 浙江产业发展情况

11.2.5 江苏产业发展规模

11.3 京津冀区域半导体产业发展分析

11.3.1 区域产业发展概况

11.3.2 北京产业发展态势

11.3.3 天津推进产业发展

11.3.4 河北产业发展综况

11.4 珠三角地区半导体产业发展分析

11.4.1 广东产业发展状况

11.4.2 深圳产业发展现状

11.4.3 广州产业发展情况

11.4.4 珠海产业发展综况

11.5 中西部地区半导体产业发展分析

11.5.1 四川产业发展综况

11.5.2 成都产业发展动态

11.5.3 湖北产业发展综况

11.5.4 武汉产业发展综况

11.5.5 重庆产业发展综况

11.5.6 陕西产业发展综况

11.5.7 安徽产业发展动态

第十二章 国外半导体产业重点企业经营分析

12.1 三星 (Samsung)

12.1.1 企业发展概况

12.1.2 财务经营状况

12.1.3 企业研发动态

12.1.4 企业投资计划

12.2 英特尔 (Intel)

12.2.1 企业发展概况

12.2.2 财务经营状况

12.2.3 企业研发动态

12.2.4 资本市场布局

12.3 SK海力士 (SK hynix)

12.3.1 企业发展概况

12.3.2 财务经营状况

12.3.3 企业研发布局

12.3.4 项目建设动态

12.3.5 对华战略分析

12.4 美光科技 (Micron Technology)

12.4.1 企业发展概况

12.4.2 财务经营状况

12.4.3 业务运营布局

12.4.4 企业竞争优势

12.4.5 企业研发布局

12.5 高通公司 (QUALCOMM, Inc.)

12.5.1 企业发展概况

12.5.2 财务经营状况

12.5.3 商业模式分析

12.5.4 业务运营状况

12.5.5 企业研发动态

12.6 博通公司 (Broadcom Limited)

12.6.1 企业发展概况

12.6.2 财务经营状况

12.6.3 研发合作动态

12.6.4 产业布局方向

12.7 德州仪器 (Texas Instruments)

12.7.1 企业发展概况

12.7.2 财务经营状况

12.7.3 产业业务部门

12.7.4 产品研发动态

12.7.5 企业发展战略

12.8 西部数据 (Western Digital Corp.)

12.8.1 企业发展概况

12.8.2 财务经营状况

12.8.3 企业竞争分析

12.8.4 项目发展动态

12.9 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)

12.9.1 企业发展概况

12.9.2 财务经营状况

12.9.3 企业发展战略

12.9.4 项目发展动态

第十三章 中国半导体产业重点企业经营分析

13.1 华为海思

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 企业经营状况

13.1.3 企业发展优势

13.1.4 未来发展布局

13.2 紫光展锐

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 企业经营状况

13.2.3 企业发展成就

13.2.4 产品研发动态

13.3 中兴微电

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 研发实力分析

13.3.3 企业发展历程

13.3.4 企业经营状况

13.3.5 企业发展战略

13.4 士兰微

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 经营效益分析

13.4.3 业务经营分析

13.4.4 财务状况分析

13.4.5 核心竞争力分析

13.4.6 公司发展战略

13.4.7 未来前景展望

13.5 台积电

13.5.1 企业发展概况

13.5.2 企业经营状况

13.5.3 项目投资布局

13.5.4 资本开支计划

13.6 中芯国际

13.6.1 企业发展概况

13.6.2 企业经营状况

13.6.3 工艺技术进展

13.6.4 企业发展前景

13.7 华虹半导体

13.7.1 企业发展概况

13.7.2 业务发展范围

13.7.3 企业发展实力

13.7.4 企业经营状况

13.7.5 产品生产进展

13.8 华大半导体

13.8.1 企业发展概况

13.8.2 主营产品分析

13.8.3 企业布局分析

13.8.4 体系认证动态

13.8.5 产品研发动态

13.9 长电科技

13.9.1 企业发展概况

13.9.2 经营效益分析

13.9.3 业务经营分析

13.9.4 财务状况分析

13.9.5 核心竞争力分析

13.9.6 公司发展战略

13.9.7 未来前景展望

13.10 北方华创

13.10.1 企业发展概况

13.10.2 经营效益分析

13.10.3 业务经营分析

13.10.4 财务状况分析

13.10.5 核心竞争力分析

13.10.6 公司发展战略

13.10.7 未来前景展望

第十四章 中国半导体行业产业链项目投资案例深度解析

14.1 半导体硅片之生产线项目

14.1.1 募集资金计划

14.1.2 项目基本概况

14.1.3 项目投资价值

14.1.4 项目投资可行性

14.1.5 项目投资影响

14.2 高端集成电路装备研发及产业化项目

14.2.1 项目基本概况

14.2.2 项目实施价值

14.2.3 项目建设基础

14.2.4 项目市场前景

14.2.5 项目实施进度

14.2.6 资金需求测算

14.2.7 项目经济效益

14.3 大尺寸再生晶圆半导体项目

14.3.1 项目基本概况

14.3.2 项目建设基础

14.3.3 项目实施价值

14.3.4 资金需求测算

14.3.5 项目经济效益

14.4 LED芯片生产基地建设项目

14.4.1 项目基本情况

14.4.2 项目投资意义

14.4.3 项目投资可行性

14.4.4 项目实施主体

14.4.5 项目投资计划

14.4.6 项目收益测算

14.4.7 项目实施进度

第十五章 半导体产业投资热点及价值综合评估

15.1 半导体产业并购状况分析

15.1.1 全球并购规模分析

15.1.2 国际企业并购事件

15.1.3 国内企业并购事件

15.1.4 国内并购趋势预测

15.1.5 市场并购应对策略

15.2 半导体产业投融资状况分析

15.2.1 融资规模数量

15.2.2 热点融资领域

15.2.3 重点融资事件

15.2.4 产业链投资机会

15.3 半导体产业进入壁垒评估

15.3.1 技术壁垒

15.3.2 资金壁垒

15.3.3 人才壁垒

15.4 集成电路产业投资价值评估及投资建议

15.4.1 投资价值综合评估

15.4.2 市场机会矩阵分析

15.4.3 产业进入时机分析

15.4.4 产业投资风险剖析

15.4.5 产业投资策略建议

第十六章 中国半导体行业上市公司资本布局分析

16.1 中国半导体行业投资指数分析

16.1.1 投资项目数

16.1.2 投资金额分析

16.1.3 项目均价分析

16.2 中国半导体行业资本流向统计分析

16.2.1 投资流向统计

16.2.2 投资来源统计

16.2.3 投资进出平衡状况

16.3 半导体行业上市公司运行状况分析

16.3.1 上市公司规模

16.3.2 上市公司分布

16.4 A股及新三板上市公司在半导体行业投资动态分析

16.4.1 投资项目综述

16.4.2 投资区域分布

16.4.3 投资模式分析

16.4.4 典型投资案例

16.5 中国半导体行业上市公司投资排行及分布状况

16.5.1 企业投资排名

16.5.2 企业区域分布

16.6 中国半导体行业重点投资标的投融资项目推介

16.6.1 中芯国际

16.6.2 TCL科技

16.6.3 三安光电

第十七章 2021-2026年中国半导体产业发展前景及趋势预测分析

17.1 中国半导体产业整体发展前景展望

17.1.1 技术发展利好

17.1.2 行业发展机遇

17.1.3 进口替代良机

17.1.4 发展趋势向好

17.2 “十四五”中国半导体产业链发展前景

17.2.1 产业上游发展前景

17.2.2 产业中游发展前景

17.2.3 产业下游发展前景

17.3 2021-2026年中国半导体产业预测分析

17.3.1 2021-2026年中国半导体产业影响因素分析

17.3.2 2021-2026年全球半导体销售额预测

17.3.3 2021-2026年中国半导体销售额预测

17.3.4 2021-2026年中国集成电路行业销售额预测

17.3.5 2021-2026年中国封装测试业销售额预测

17.3.6 2021-2026年中国半导体应用市场预测

图表目录

图表1 半导体分类结构图

图表2 半导体分类

图表3 半导体分类及应用

图表4 半导体产业链示意图

图表5 半导体上下游产业链

图表6 半导体产业转移和产业分工

图表7 集成电路产业转移状况

图表8 全球主要半导体厂商

图表9 2017-2021年全球半导体市场规模及增长率

图表10 2017-2021年全球半导体月度收入及增速

图表11 2017-2021年全球半导体研发支出水平情况

图表12 2021年全球半导体市场结构

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/552273552273.html>